

## CMC AISiC 散熱片

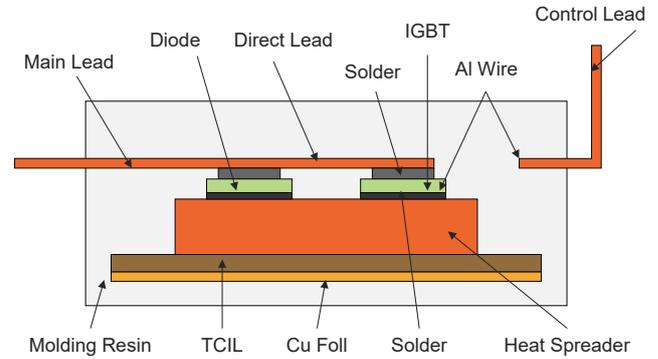
RoHS Compliant

### 一般說明 General Description

陶瓷基複合材料，用以提升電子元件的熱導率與散熱效率。

### 產品特性 Feature

- 優異的高溫加工穩定性
- 經熱循環與可焊性測試後無翹曲現象
- 低熱膨脹係數與高熱導率
- 重量低於銅
- 厚度可薄型化不會翹曲，最薄可達 1mm
- 通過抗振動測試
- 經熱循環測試後的使用壽命優於銅



可作為銅 (Cu) 或鉬銅 (Mo-Cu) 的替代材料。

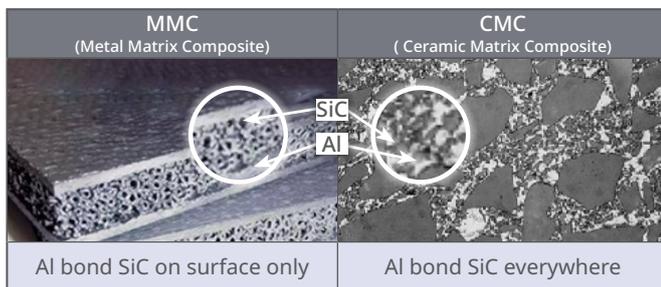
### 產品規格 Specification

Properties	Unit	CMC AISiC
導熱係數 Thermal Conductivity	W/m·K	150~180 (Based on different thickness)
標準品尺寸 Standard Product Dimensions L × W × H	mm	187x137x4.8
		140x99.5x4.65
		107x62x3.25
		39.5x39.5x1.6
熱膨脹係數 Coefficient of Thermal Expansion, CTE	PPM/K	7~10
剛性 Strength	MPa	>300
表面處理 Plating	μm	Ni --- 3
密度 Density	g/cm <sup>3</sup>	2.6~3.0

※ 尺寸可客製化。Product dimensions can be customized.

※ 產品出貨前，皆依規範進行表面鍍鎳處理。All products undergo surface nickel plating in accordance with specifications prior to shipment.

### CMC AISiC 與 MMC 材料比較：



高柏科技股份有限公司 T-Global Techonology Co., Ltd.

330058 桃園市桃園區大仁路 50 巷 33 號 No. 33, Ln. 50, Daren Rd., Taoyuan Dist., Taoyuan City 330058, Taiwan

T +886-3-361-8899 E service@tglobalcorp.com W www.tglobalcorp.com

Version20  
20251218



注意：本技術數據表內的資訊是根據高柏團隊的研究與測試得出的最佳數據。本技術數據表中列出的值僅代表典型值，並非對每一批生產的物料都進行測試。

所有規格如有變更，恕不另行通知；無影響產品功能之保護膜及離型紙，如非特殊要求，皆依高柏默認為準。由於各種可能的使用條件超出了我們的控制範圍，因此我們提出的所有建議均不構成保證或責任，用戶應自行進行測試，以確定我們的產品在任何特定情況下的適用性。本產品的銷售沒有任何明示或暗示的說明，表示其適用於特定目的或其他用途的保證，但本產品應依據高柏與您確認的發票、報價、或 訂單，提供最標準的產品質量。我們不承擔使用者如何延伸或改變此技術數據表中的資訊，使用者應承擔所有風險。此外，本技術數據表中的資訊不包含任何內容解釋與涉及產品材料的現有用途、未來專利衝突、工藝製造，與使用產品的建議。